

厦门市人民政府办公厅文件

厦府办〔2018〕185号

厦门市人民政府办公厅关于调整 加快发展集成电路产业实施细则的通知

各区人民政府，市直各委、办、局，各开发区管委会：

经市政府研究同意，决定调整《厦门市人民政府办公厅关于印发加快发展集成电路产业实施细则的通知》（厦府办〔2018〕58号）第十七条“流片补助”第（一）款补助标准。现将调整有关事项通知如下：

一、原条文“用于研发的集成电路企业 MPW，按照不高于 MPW 直接费用 70% 进行资助，用于研发的集成电路企业工程片试流片按照不高于其加工费 30% 进行资助。”调整为“用于研发的

集成电路企业 MPW,按照不高于 MPW 直接费用 70% 进行资助,用于研发的集成电路企业工程片试流片按照不高于其加工费 30% 进行资助。针对硅 CMOS 工艺最小线宽 $\leq 55\text{nm}$ 、GaAs MMIC 工艺最小线宽 $\leq 250\text{nm}$ 等两类先进工艺,在以上标准基础上分别提高 10 个百分点,即 MPW 直接费用按照不高于 80% 进行资助,工程片试流片按照不高于其加工费 40% 进行资助。”

二、本实施细则调整通知的“流片补助”标准从 2018 年 1 月 1 日(含)起执行。

三、本实施细则调整通知由 IC 办负责解释,与《厦门市人民政府关于印发加快发展集成电路产业实施意见的通知》(厦府[2016]220 号)、《厦门市人民政府办公厅关于印发加快发展集成电路产业实施细则的通知》(厦府办[2018]58 号)配套实施。



(此件主动公开)

厦门市人民政府办公厅

2018 年 10 月 9 日印发

